香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION
合肥晶合集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2249)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列合肥晶合集成電路股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年11月9日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生及楊國慶女士；及(iii)獨立非執行董事盛明泉教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-055

合肥晶合集成电路股份有限公司
关于回购 A 股股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 5 日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-049）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购 A 股股份决议的前一个交易日（即 2026 年 11 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例公告如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股份种类
1	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	468,474,592	20.96	A 股
2	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	328,736,799	14.71	A 股
3	HKSCC NOMINEES LIMITED	227,053,899	10.16	H 股
4	力晶创新投资控股股份有限公司	161,984,487	7.25	A 股
5	华勤技术股份有限公司	120,368,109	5.39	A 股
6	合肥勤合电子科技有限公司	100,379,585	4.49	A 股
7	招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	65,034,410	2.91	A 股
8	合肥晶合集成电路股份有限公司回购专用证券账户	62,088,500	2.78	A 股
9	招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	45,258,119	2.03	A 股
10	中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式	42,845,319	1.92	A 股

	优选混合型证券投资基金（LOF）			

注：1、公司的前十名股东和前十名无限售条件股东一致。HKSCC NOMINEES LIMITED 为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其中 107,910,400 股为公司 H 股发行上市的基石投资人所持股份，目前尚处于锁定期；

2、“持股比例”为股东持股数量占公司总股本 2,234,787,210 股的比例；“股份种类”中，A 股指人民币普通股，H 股指境外上市外资股；

3、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日